

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 3 月 15 日 (15.03.2001)

PCT

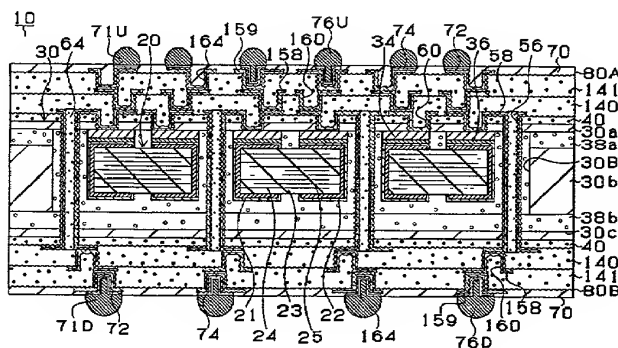
(10) 国際公開番号
WO 01/19148 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H05K 3/46, H01G 4/008 特願2000/230868 2000年7月31日 (31.07.2000) JP
特願2000/230869 2000年7月31日 (31.07.2000) JP
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05970 特願2000/230870 2000年7月31日 (31.07.2000) JP
(22) 国際出願日: 2000 年 9 月 1 日 (01.09.2000) (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イビデン株式会社 (IBIDEN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gifu (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語 (72) 発明者; および
(30) 優先権データ: (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 稲垣 靖 (INAGAKI, Yasushi) [JP/JP]. 浅井元雄 (ASAI, Motoo) [JP/JP]. 王 東冬 (WANG, Dongdong) [JP/NZ]. 矢橋英郎 (YABASHI, Hideo) [JP/JP]. 白井誠二 (SHIRAI, Seiji) [JP/JP]; 〒501-0695 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1丁目1番地 イビデン株式会社 大垣北工場内 Gifu (JP).
特願平11/248311 1999 年 9 月 2 日 (02.09.1999) JP
特願平 11/369003 1999 年 12 月 27 日 (27.12.1999) JP
特願2000/221350 2000 年 7 月 21 日 (21.07.2000) JP

[続葉有]

(54) Title: PRINTED WIRING BOARD AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

発明の名称: プリント配線板及びその製造方法



(57) Abstract: Chip capacitors (20) are arranged in a core board (30) for a printed wiring board (10). This makes it possible to reduce the distance between an IC chip (90) and the chip capacitor (20) and to reduce the loop inductance. The core board (30), which is a lamination consisting of a first resin board (30a), a second resin board (30b), and a third resin board (30c), has a sufficient strength.

(57) 要約:

プリント配線板 10 のコア基板 30 内に、チップコンデンサ 20 を配設する。これにより、IC チップ 90 とチップコンデンサ 20 との距離が短くなり、ループインダクタンスを低減することが可能となる。第 1 樹脂基板 30 a、第 2 樹脂基板 30 b、第 3 樹脂基板 30 c を積層してなるので、コア基板 30 に十分な強度を得ることができる。